

智慧財產及商業法院民事判決

111年度民專訴字第12號

原告 羅彥君即翊宇科技企業社

訴訟代理人 蔣昕佑律師
陳冠宏律師
楊雯欣律師
陳豫宛專利師

被告 上和精密工業有限公司

兼法定代理人 羅彥文

被告 欣興電子股份有限公司

兼法定代理人 曾子章

上二人共同

訴訟代理人 陳軍宇律師
複代理人 黃郁孟律師
黃宣瑀律師

輔佐人 李昇叡

被告 加逢實業股份有限公司

法定代理人 黃經國

被告 泓揚精密工業股份有限公司

兼法定代理人 陳能敏

01 上二人共同
02 訴訟代理人 吳聖欽律師
03 被 告 超登企業有限公司

04 兼法定代理
05 人 李月圓
06 上二人共同
07 訴訟代理人 王文成律師
08 劉蘊文律師
09 陳政大專利師

10 蔡孟熹專利師

11 上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於民國11
12 2年4月18日言詞辯論終結，判決如下：

13 主 文

14 原告之訴及假執行之聲請均駁回。

15 訴訟費用由原告負擔。

16 事實及理由

17 壹、程序方面：

18 按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之
19 基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2
20 款定有明文。原告起訴以被告上和精密工業有限公司(下稱
21 上和公司)委託加逢實業股份有限公司(下稱加逢公司)製
22 造、販售予欣興電子股份有限公司(下稱欣興公司，與上和
23 公司、加逢公司合稱欣興公司等3公司)之載有「SH 0000
24 0」、「SH 000000000000」字樣晶圓載片清洗治具(下依序
25 稱產品1、2)，及欣興公司使用之載有「HY 00000」字樣晶
26 圓載片清洗治具(下稱產品3)，侵害中華民國新型第M588880
27 號「具有防呆裝置之晶圓載片清洗治具」與新型第M606835
28 號「晶圓載片清洗治具」專利(下依序稱專利1、2，合稱系
29 爭專利)，請求上和公司與其法定代理人羅彥文(下稱羅彥
30 文)、欣興公司與其法定代理人曾子章(下稱曾子章)賠償損

01 害，及欣興公司等3公司應除去、防止侵害(見本院卷(一)第19
02 至39頁)。嗣以其依本院110年度民聲字第22號保全證據事件
03 裁定對欣興公司新豐廠實施保全證據時，所取得產品3為泓
04 揚精密工業股份有限公司(下稱泓揚公司)製造、販售。另取
05 得侵害系爭專利之載有「ZD 00000」字樣之晶圓載片清洗治
06 具(下稱產品4，與產品1、2、3合稱系爭產品)，係超登企業
07 有限公司(下稱超登公司，與泓揚公司、欣興公司等3公司合
08 稱超登公司等5公司)製造、販售，乃具狀追加泓揚公司與其
09 法定代理人陳能敏(下稱陳能敏)、超登公司與其法定代理人
10 李月圓(下稱李月圓，與超登公司等5公司、羅彥文、曾子
11 章、陳能敏合稱被告)為被告，請求其等賠償損害，及泓揚
12 公司、超登公司應除去、防止侵害，並為如下貳、一之聲明
13 (見本院卷(三)第5至17頁)，核其追加對泓揚公司、陳能敏、
14 超登公司、李月圓之請求，與起訴請求均係基於欣興公司使
15 用系爭產品侵害系爭專利之同一基礎事實，依上開規定，應
16 准許之。

17 貳、實體方面：

18 一、原告主張：伊為系爭專利專屬被授權人，將系爭專利用於製
19 造、銷售晶圓載片清洗治具，而一組清洗治具包含二個能分
20 離疊合之放置架，各放置架包含外環壁、複數個放置單元及
21 複數個防呆部，其中放置單元依晶圓加工業者生產之晶圓載
22 片大小而有不同規格，專利1係將清洗治具之防呆部設置為
23 可與沖洗用水道之齒盤或鍊條等傳動裝置相互卡合，改善先
24 前技術未能卡合導致晶圓載片在輸送過程中因震動、彈跳產
25 生瑕疵之缺失；專利2係將清洗治具用以支撐晶圓載片之承
26 載件設置為斜面，以降低清洗過程中晶圓與清洗治具承載件
27 接觸產生之刮痕。伊前為配合欣興公司新豐廠產線需求，以
28 系爭專利之技術特徵設計開發特殊規格之清洗治具供新豐廠
29 使用。詎伊於民國110年4、5月間發現欣興公司新豐廠另使
30 用上和公司委託加達公司製造之產品1、2；泓揚公司製造之
31 產品3；超登公司製造之產品4，經伊取得系爭產品比對分
32 析，發現系爭產品均落入專利1請求項1至14之文義範圍，產

品3另落入專利2請求項1之文義範圍及請求項3至6之均等範圍，而上和公司之代表人羅彥文為伊胞弟，在伊處任職時曾接觸專利1之技術內容，欣興公司則知悉新豐廠使用之清洗治具需利用系爭專利始能製造，上和公司製造、銷售產品1、2及欣興公司使用系爭產品，均係故意侵害系爭專利。又泓揚公司、超登公司與伊同業，應熟悉相關技術與產品特性，得於生產、銷售時就所實施之技術為最低限度之專利權查證，其等仍製造、銷售侵害系爭專利之產品3、4，各應負過失責任，伊因系爭專利遭侵害受有損害，欣興公司應各與上和公司、泓揚公司、超登公司負連帶賠償責任，上開公司之負責人曾子章、羅彥文、陳能敏、李月圓，應各與所屬公司負連帶賠償責任，超登公司等5公司並應負除去、防止侵害之責。爰依專利法第120條準用第96條第1項、第3項、第4項規定請求排除侵害，並依同法第120條準用第96條第2項、第4項、民法第184條第1項前段、第185條第1項、公司法第23條第2項規定，就產品1、2請求連帶賠償新臺幣(下同)200萬元；產品3、4各請求連帶賠償100萬元，及法定遲延利息，並聲明：(一)上和公司、欣興公司應連帶給付原告200萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。(二)羅彥文應就前項給付與上和公司負連帶給付責任。(三)曾子章應就第一項給付與欣興公司負連帶給付責任。(四)前三項給付，如任一人已為給付者，其餘人於給付範圍內同免給付義務。(五)欣興公司、泓揚公司應連帶給付原告100萬元，及欣興公司自起訴狀繕本送達翌日起，泓揚公司自訴之變更追加狀送達翌日起，均至清償日止，按年息5%計算之利息。(六)曾子章應就第五項給付與欣興公司負連帶給付責任。(七)陳能敏應就第五項給付與泓揚公司負連帶給付責任。(八)前三項給付，如任一人已為給付者，其餘人於給付範圍內同免給付義務。(九)欣興公司、超登公司應連帶給付原告100萬元，及自訴之變更追加狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。(十)曾子章應就第九項給付與欣興公司負連帶給付責任。□李月圓應就第九項給付與超登公司負連帶

[illegible]

(3)請求項3至14部分：

請求項3至14為請求項1之附屬項，系爭產品未落入請求項1之文義範圍，當未落入請求項3至14之文義範圍。

3.產品3未落入專利2請求項1之文義範圍及請求項3至6之均等範圍：

(1)請求項1部分：

產品3抵頂面呈現「○○○」之樣態，與請求項1「抵頂面與晶圓載片清洗治具」呈現「線接觸」之技術特徵不同，產品3顯不符合請求項1「一種晶圓載片清洗治具，其包含…各該承載件具有一抵頂面，該抵頂面為一斜面，且自位於該內框的上方位位置朝向該容置空間的方向向下傾斜…」之文義與均等範圍。

(2)請求項3至6部分：

請求項3至6為請求項1之附屬項，產品3未落入請求項1之文義與均等範圍，當未落入請求項3至6之均等範圍。

4.專利1違反專利法第120條準用第26條第1項、第2項之規定：

專利1說明書、圖示未揭示「下防呆部」有「卡合凸塊」，即未明確記載專利1之「下防呆部」如何與輸送該放置架之傳動裝置相「卡合」，專利1請求項2不為其說明書所支持，所屬技術領域中具有通常知識者，無法依專利1說明書瞭解請求項2之內容，自無法據以實現，有違專利法第120條準用第26條第1項、第2項規定，附屬於請求項2之請求項3至14，亦同。

5. 專利1請求項1至3不具新穎性；請求項1至14不具進步性：

01 被證1或被證1、被證21、被證22或被證1、被證21、被證2
02 2、被證24之組合，已分別揭示「清洗治具與傳動裝置相卡
03 合」、「各卡合凸塊之位置高於各限位件的上端」等技術特
04 徵，所屬技術領域中具有通常知識者亦有結合上開證據之動
05 機，請求項1至3不具新穎性，而請求項1至14得由所屬技術
06 領域中具通常知識者，依上開證據輕易完成，該等請求項亦
07 不具進步性。

08 6.專利2請求項1、3至5不具新穎性；請求項1、3至6不具進步
09 性：

10 (1)被證3或被證3、被證4或被證3、被證25之組合，已揭露請求
11 項1「各承載件具有一抵頂面，該抵頂面為一斜面，且自位
12 於該內框的上方位位置朝向該容置空間的方向向下傾斜，其
13 中，向下傾斜角度為以該抵頂面的最高點與最低點之間連接
14 之假想線與經過該抵頂面的最高點的假想水平線之間的夾角
15 角度」之技術特徵，所屬技術領域中具有通常知識者亦有結
16 合上開證據之動機，且被證3、被證4或被證3、被證25相結
17 合後，因晶圓載片將與抵頂之元件呈現線接觸，自然達成
18 「降低震盪造成晶圓載片表面刮痕」之功效，請求項1實不
19 具新穎性、進步性。

20 (2)請求項3至5之技術特徵已為被證3所揭露或僅為被證3之簡單
21 變更；請求項6之技術特徵為被證3、被證4或被證25之簡單
22 變更，則被證3或被證3、被證4或被證3、被證25之組合，足
23 以證明請求項3至5不具新穎性、進步性，及請求項6不具進
24 步性。

25 7.系爭產品未落入專利1請求項1至14之文義範圍，產品3未落
26 入專利2請求項1之文義範圍及請求項3至6之均等範圍，系爭
27 專利復有上開無法據以實現，或不具新穎性、進步性之撤銷
28 原因，原告以系爭產品侵害系爭專利為由，請求伊等連帶賠
29 償，欣興公司並應負除去、防止侵害之責，均無理由。

30 (二)上和公司、羅彥文部分：

31 除引用欣興公司之抗辯內容外，另補陳：羅彥文未曾於原告
32 處任職，專利1之專利權為羅彥文所有，原告不得對伊等主

(三)加逢公司部分：

除引用欣興公司之抗辯內容外，另補陳：伊為塑膠射出成型廠，108年10月起受上和公司委託，由上和公司提供模具、原料進行晶圓載片清洗治具之模具試模與製造，產品製造完成後之加工、品檢、包裝、出貨等均係上和公司處理，伊不知產品1、2具有專利，對於產品1、2之原料、器具及成品均無處置權等語。

(四)泓揚公司、陳能敏部分：

除引用欣興公司之抗辯內容外，另補陳：原告未在系爭專利產品或其包裝上標示專利證書號數，依專利法第120條準用第98條規定，不得請求損害賠償。又泓揚公司係依欣興公司提供之設計規範與外觀圖繪圖後，開模製造產品3供欣興公司使用，並未接觸系爭專利，無侵害系爭專利之故意或過失等語。

(五)超登公司、李月圓部分：

1.產品4不具有○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○0○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○，未落入專利1文義與均等範圍，不會構成
對專利1之侵害。

2.專利1之請求項1至14違反專利法第120條準用第26條規定：

(1)請求項1僅界定「複數個卡合凸塊能與輸送放置架的傳動裝置相卡合」，未記載卡合之技術手段及卡合凸塊與習知技術之上防呆部區別，無法瞭解卡合凸塊如何與傳動裝置之傳動元件或非傳動元件相卡合，無法由請求項之內容瞭解其意義，其內容亦欠缺必要技術特徵，請求項1對應之說明書記載不明確且未充分揭露，無從據以實現，違反專利法第120條準用第26條規定。

(2)專利1請求項2至14直接或間接依附於請求項1，包含請求項1所有技術特徵，與請求項1同樣違反專利法第120條準用第26條規定。

3.專利1請求項1至14違反專利法第120條準用第22條規定：

(1)請求項1、2部分：

①專利1先前技術所載技術內容及對應圖式與超乙證1先前技術所載相同，而超乙證1公告日早於專利1申請日，專利1先前技術即為所屬技術領域之通常知識，而專利1先前技術已揭示請求項1所有技術特徵，請求項1不具新穎性，且所屬技術領域中具有通常知識者依專利1先前技術能輕易完成請求項1，請求項1不具進步性，超乙證1或超乙證1、專利1先前技術之組合當亦足以證明請求項1不具新穎性、進步性。

②專利1先前技術或超乙證1說明書第【0022】段內容，均揭示請求項2之技術特徵，請求項2不具新穎性、進步性。超乙證1、專利1先前技術之組合，亦足以證明請求項2不具進步性。

(2)請求項3至5部分：

①專利1先前技術記載：「放置架90的上防呆部93與另一放置架90的下防呆部94配合」，其中上防呆部已揭示卡合凸塊、下防呆部已揭示卡合凹部；說明書第【0025】段記載「限位件13的設置方式已為習知技術」，或超乙證1說明書第【0030】段所載，均揭示請求項3之技術特徵，所屬技術領域中具有通常知識者能據以輕易完成限位件之結構、位置、高度與長度等之修改。又超乙證2揭示一種用於清洗半導體封裝基板的夾具，其圖11揭示載板的堆疊；圖2揭示外周緣上設置有定位的凸起27（即卡合凸塊）；圖3揭示周壁上的限位件34、35，且凸起27的位置較周壁高，已揭示請求項3中「各卡合凸塊的位置高於各限位件的上端」之技術特徵。

②專利1先前技術記載：「放置架90的上防呆部93與另一放置架90的下防呆部94配合」，已揭示請求項4之全部技術特徵，而超乙證1先前技術揭示與專利1先前技術相同之技術內容，所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成請求項4，請求項4不具進步性。又超乙證1說明書第【0022】段記載：「請參閱圖1、圖2及圖3所示，本實施例中，下放置架10上進一步設有一下防呆部13，而上放置架20上進一步設有一上防呆部21」，已揭示請求項4之全部技術特徵。

01 ③依超乙證1圖2所示，其防呆部之形狀係對稱，而清洗治具之
02 對稱設計，為所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成，
03 可知請求項5不具進步性。

04 ④從而，專利1先前技術或超乙證1或超乙證1、專利1先前技術
05 或專利1先前技術、超乙證2或超乙證1、超乙證2或超乙證
06 1、專利1先前技術、超乙證2之組合，均足以證明請求項3至
07 5不具進步性。

08 (3)請求項6至9部分：

09 ①依超乙證2圖2之標籤24及說明書第【0064】段記載，已揭示
10 請求項6「遮斷器」之技術特徵。又依超乙證3之圖3及說明
11 書第【0064】段記載，帶鋼片之定位孔24可經由鋼片遮斷光
12 線，並據此提供定位功能，超乙證3亦揭示請求項6「遮斷
13 器」技術特徵。

14 ②各式載具、托盤等之結構設計，用以遮斷光線之遮斷器可依
15 實際載具、托盤等結構而改變，為所屬技術領域之通常知識
16 ，且請求項7之遮斷器位置未產生無法預期之功效，所屬領
17 域中具有通常知識者，可依實際設計需求修改超乙證2之標
18 籤24之數量及位置，輕易完成請求項7之技術特徵。又超乙
19 證3之圖3已揭示帶鋼片之定位孔24設置於放置架的4個角
20 落，亦揭示請求項7之技術特徵。

21 ③依專利1說明書第【0030】段記載，可知夾制部的形狀和數
22 量並未產生無法預期之功效。超乙證1說明書第【0021】段
23 揭示請求項8「夾制部」之技術特徵。超乙證2之圖5 揭示傳
24 送板42位於外環壁上，且以平板狀延伸，可以做為機械手臂
25 夾持之作用，亦揭示請求項8「夾制部」技術特徵。

26 ④請求項9之夾制部形狀和數量未產生無法預期之功效，已如
27 前述，該請求項之夾制部雖具有斜面，惟所屬技術領域中具
28 有通常知識為了解決引導水流而進行排水的問通，可在夾制
29 部上表面設計斜面引導水由高處流往低處，因此，以斜面引
30 導水流往低處而進行排水僅為固有功能，亦未產生無法預期
31 之功效。又超乙證1之拿持部12為一平板狀結構；超乙證2圖
32 5揭示傳送板42位於外環壁上，且以平板狀延伸，為解決引

導水流排水而將平板狀之結構修改呈傾斜狀，為具有通常知識者依據通常知識能輕易完成。

⑤從而，專利1先前技術、超乙證2或超乙證1、超乙證2或超乙證1、專利1先前技術、超乙證2或專利1先前技術、超乙證2、超乙證3或超乙證1、超乙證2、超乙證3或超乙證1、專利1先前技術、超乙證2、超乙證3之組合，均足以證明請求項6至9不具進步性。

(4)請求項10至14部分：

①依專利1說明書第【0031】段所載，可知拿持部、排水孔的形狀與數量，未產生無法預期之功效，所屬技術領域中具有通常知識者，為解決使用者拿取放置架的問題，可輕易在放置架設置可供拿持之拿持部，並在拿持部設置排水孔，以解決排水問題。又超乙證1說明書第【0021】段記載，已揭示請求項10「拿持部」技術特徵，所屬技術領域中具有通常知識者，可據以輕易完成在拿持部設置排水孔。另超乙證2圖8之標籤62，亦可供使用者拿持，揭示請求項10「拿持部」技術特徵。超乙證2圖9之標籤62上設有結合孔63，當然可供水流通過，已揭示拿持部設有排水孔。再超乙證4揭示一種堆疊治具，其圖3揭示在底板兩側相較於其底部具有突出部位可供使用者拿持，揭示超乙證1的拿持部，其圖3揭示底板兩側之突出部位開設有開口13，揭示拿持部設有排水孔。

②請求項11之拿持部、排水孔的形狀與數量，未產生無法預期之功效，所屬技術領域中具有通常知識者，為解決排水問題，亦可在拿持部設置排水孔及調整排水孔之數量。

③依超乙證1說明書第【0027】段之記載及超乙證1圖4、5揭示支撐部32不相連，其上方為頂面，且頂面朝向上方且為凸面，已揭示請求項12之全部技術特徵。

④超乙證1說明書第【0032】段記載：「請參閱圖4所示，本實施例中，各限位部40為一徑向大小由上逐漸向下遞增的柱狀，更精確地說，為一錐狀柱，但限位部40的形狀亦不以此為限。」已揭示請求項13「限位件為柱狀」之技術特徵。依超乙證4圖3、4，其限位件上端為凸面(凸出於頂面)，已揭

01 示請求項13「限位件的上端為凸面」之技術特徵；超乙證4
02 圖3揭示定位銷12為柱狀，該限位件上端為凸面。另超乙證2
03 之圖5揭示限位件為柱狀，且限位件之上端為凸面，已揭示
04 請求項13所有技術特徵。

05 ⑤超乙證1說明書第【0032】段之記載，已揭示請求項14所有
06 之技術特徵。超乙證2圖5及超乙證4圖3，揭示限位件為柱
07 狀，且限位件外徑由其上端向下逐漸遞增，均揭示請求項14
08 所有技術特徵。

09 ⑥從而，專利1先前技術、超乙證2或超乙證1、超乙證2或超乙
10 證1、專利1先前技術、超乙證2或專利1先前技術、超乙證
11 2、超乙證3或超乙證1、超乙證2、超乙證3或超乙證1、專利
12 1先前技術、超乙證2、超乙證3或專利1先前技術、超乙證
13 2、超乙證4或超乙證1、超乙證2、超乙證4或超乙證1、專利
14 1先前技術、超乙證2、超乙證4或專利1先前技術、超乙證
15 2、超乙證3、超乙證4或超乙證1、超乙證2、超乙證3、超乙
16 證4或超乙證1、專利1先前技術、超乙證2、超乙證3、超乙
17 證4之組合，足以證明請求項10至14不具進步性。

18 (5)專利1先前技術、超乙證2或超乙證1、超乙證2或超乙證1、
19 專利1先前技術、超乙證2之組合，足以證明請求項1、2不具
20 進步性。

21 (6)專利1先前技術、超乙證2、超乙證3或超乙證1、超乙證2、
22 超乙證3或超乙證1、專利1先前技術、超乙證2、超乙證3之
23 組合，足以證明請求項1至5不具進步性。

24 (7)專利1先前技術、超乙證2、超乙證4或超乙證1、超乙證2、
25 超乙證4或超乙證1、專利1先前技術、超乙證2、超乙證4或
26 專利1先前技術、超乙證2、超乙證3、超乙證4或超乙證1、
27 超乙證2、超乙證3、超乙證4或超乙證1、專利1先前技術、
28 超乙證2、超乙證3、超乙證4之組合，足以證明請求項1至9
29 不具進步性。

30 (六)均聲明：1.原告之訴駁回。2.如受不利益判決，願供擔保請
31 准宣告免為假執行。

01 三、兩造不爭執事項(見本院卷(四)第148至149頁，並依判決格式
02 修正或刪減文句)：

03 (一)原告為專利1專屬被授權人，授權期間自109年1月1日至專利
04 1專利期間屆滿日止。

05 (二)原告為專利2專屬被授權人，授權期間自110年1月21日至專
06 利2專利期間屆滿日止。

07 (三)產品1、2為欣興公司委託上和公司製造，上和公司再委託加
08 逢公司製造，由上和公司販賣予欣興公司使用。

09 (四)產品3為欣興公司委託泓揚公司製造，由泓揚公司製造後販
10 賣予欣興公司使用。

11 (五)產品4為欣興公司委託超登公司製造，由超登公司製造後販
12 賣予欣興公司使用。

13 (六)上開事實，並有兩造不爭執真正之經濟部商工登記公示資料
14 查詢(見本院卷(一)第43、107至108、111至114頁、卷(三)第27
15 至28、37頁)、系爭專利新型說明書公告本、專利證書(見本
16 院卷(一)第45至90、491、493頁)、專利授權契約(見本院卷(一)
17 第91至97頁)、經濟部智慧財產局函(見本院卷(一)第99、101
18 頁)、原告製造、販賣之晶圓載片清洗治具(見本院卷(一)第10
19 3至106頁)、交貨單照片(見本院卷(一)第109至110頁)可稽，
20 堪認屬實。

21 四、經本院於112年3月30日與兩造整理並協議簡化爭點為(見本
22 院卷(四)第149至151頁，並依本院論述與妥適調整文句)：

23 (一)系爭產品是否落入專利1請求項1至14文義範圍？

24 (二)產品3是否落入專利2請求項1文義範圍及請求項3至6均等範
25 圍？

26 (三)專利1是否有應撤銷之原因？

27 1.專利1請求項1至14是否違反專利法第26條第1項、第2項、第
28 4項及專利法施行細則第18條第2項規定？

29 2.被證1是否足以證明專利1請求項1至3不具新穎性？

30 3.被證1是否足以證明專利1請求項1至14不具進步性？

31 4.被證1、被證21、被證22之組合是否足以證明專利1請求項
32 1、2不具進步性？

01 5.被證1、被證21、被證22、被證24之組合是否足以證明專利1
02 請求項3至14不具進步性？

03 6.超乙證1或專利1先前技術是否足以證明專利1請求項1、2不
04 具新穎性？

05 7.超乙證1或專利1先前技術是否足以證明專利1請求項1至5不
06 具進步性？

07 8.超乙證1、專利1先前技術之組合是否足以證明專利1請求項1
08 至5不具進步性？

09 9.專利1先前技術、超乙證2或超乙證1、超乙證2或超乙證1、
10 專利1先前技術、超乙證2之組合，是否足以證明專利1請求
11 項1至14不具進步性？

12 10.專利1先前技術、超乙證2、超乙證3或超乙證1、超乙證2、
13 超乙證3或專利1先前技術、超乙證1、超乙證2、超乙證3之
14 組合，是否足以證明專利1請求項1至14不具進步性？

15 11.專利1先前技術、超乙證2、超乙證4或超乙證1、超乙證2、
16 超乙證4或專利1先前技術、超乙證1、超乙證2、超乙證4或
17 專利1先前技術、超乙證2、超乙證3、超乙證4或超乙證1、
18 超乙證2、超乙證3、超乙證4或專利1先前技術、超乙證1、
19 超乙證2、超乙證3、超乙證4之組合，是否足以證明專利1請
20 求項1至14不具進步性？

21 (四)專利2是否有應撤銷之原因？

22 1.被證3是否足以證明專利2請求項1、3至5不具新穎性？

23 2.被證3是否足以證明專利2請求項1、3至5不具進步性？

24 3.被證3、被證4之組合是否足以證明專利2請求項1、3至6不具
25 進步性？

26 4.被證3、被證25之組合是否足以證明專利2請求項1、3至6不
27 具進步性？

28 (五)原告依專利法第120條準用第96條第2項及第4項本文、民法
29 第184條第1項前段及第185條第1項，請求欣興公司、上和公
30 司負連帶賠償責任有無理由？原告依公司法第23條第2項規
31 定請求曾子章、羅彥文就前開損害賠償額分別與欣興公司、

01 上和公司負連帶賠償責任，有無理由？產品1、2是否為欣興
02 公司委託上和公司設計？

03 (六)原告依專利法第120條準用第96條第2項及第4項本文、民法
04 第184條第1項前段及第185條第1項，請求欣興公司、泓揚公
05 司負連帶賠償責任有無理由？原告依公司法第23條第2項規
06 定請求曾子章、陳能敏就前開損害賠償額分別與欣興公司、
07 泓揚公司負連帶賠償責任，有無理由？

08 (七)原告依專利法第120條準用第96條第2項及第4項本文、民法
09 第184條第1項前段及第185條第1項，請求欣興公司、超登公
10 司負連帶賠償責任有無理由？原告依公司法第23條第2項規
11 定請求曾子章、李月圓就前開損害賠償額分別與欣興公司、
12 超登公司負連帶賠償責任，有無理由？

13 (八)本件損害賠償數額如何計算？

14 (九)原告主張之排除侵害及請求回收銷毀侵害系爭專利之物品，
15 有無理由？

16 五、本院之判斷：

17 (一)系爭專利技術分析：

18 1.專利1：

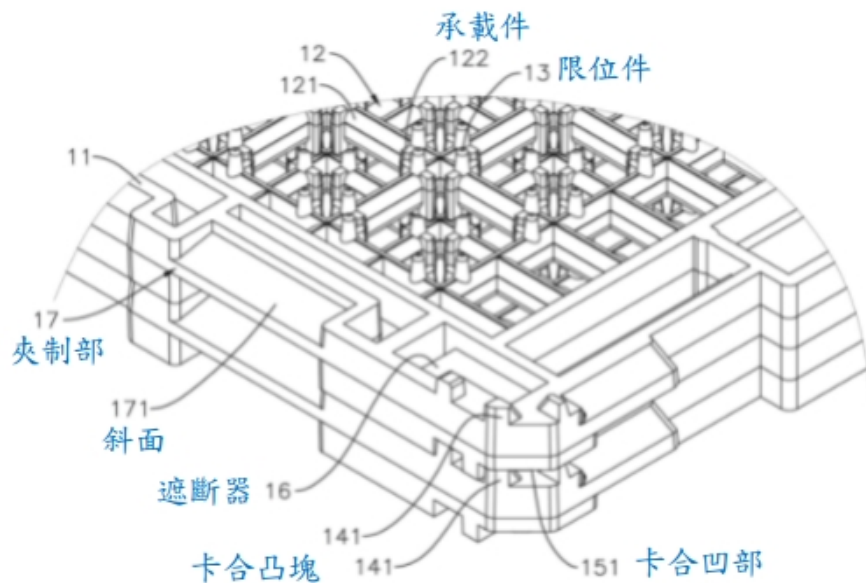
19 (1)技術內容：

20 晶圓載片上裝設有晶圓片，對晶圓載片進行電路蝕刻及將晶
21 圓載片切割成較小的片狀後，為清除蝕刻電路過程殘留之油
22 墨，及清除切割晶圓載片過程產生之碎屑，會清洗晶圓載片
23 表面，避免油墨、碎屑影響晶圓與整片晶圓載片之使用效
24 能。載有晶圓載片之放置架會被放入沖洗用之水道，水道中
25 設有可帶動放置架移動之傳動裝置，傳動裝置通常會有鏈條
26 或齒盤等結構配合帶動放置架，在放置架移動同時，水道內
27 會有聲波震動以清除晶圓載片表面上之油墨及碎屑。但現有
28 放置架之防呆設計於傳動裝置傳動時，無法與傳動裝置之傳
29 動元件(如齒盤、鍊條等)卡合，放置架於傳動裝置輸送時因
30 此會滑移或晃動，致晶圓載片因震動或彈跳產生瑕疵，降低
31 晶圓載片之使用效能及產品良率，為改善現有晶圓清洗裝置
32 之技術缺失，專利1之防呆部包含複數個卡合凸塊，能與輸

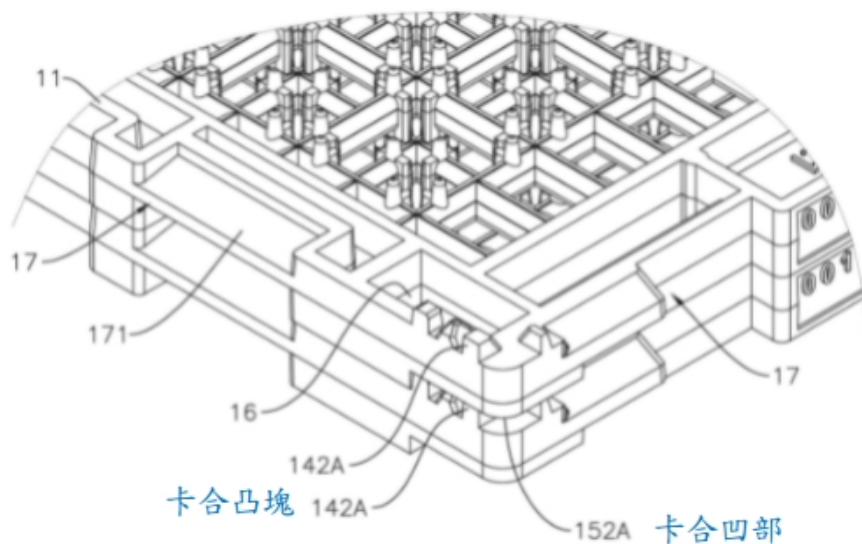
送放置架之傳動裝置相卡合，避免放置架於傳動裝置輸送時滑移或晃動，提升放置架輸送穩定度。專利1之防呆部包含複數個卡合凸塊，其能和傳動裝置之傳動元件(如齒盤、鍊條等)相卡合，讓放置架更穩定地被傳動裝置輸送，避免晶圓載片震動或彈跳而產生瑕疵，提升放置架之輸送穩定度。

(2)主要圖式：

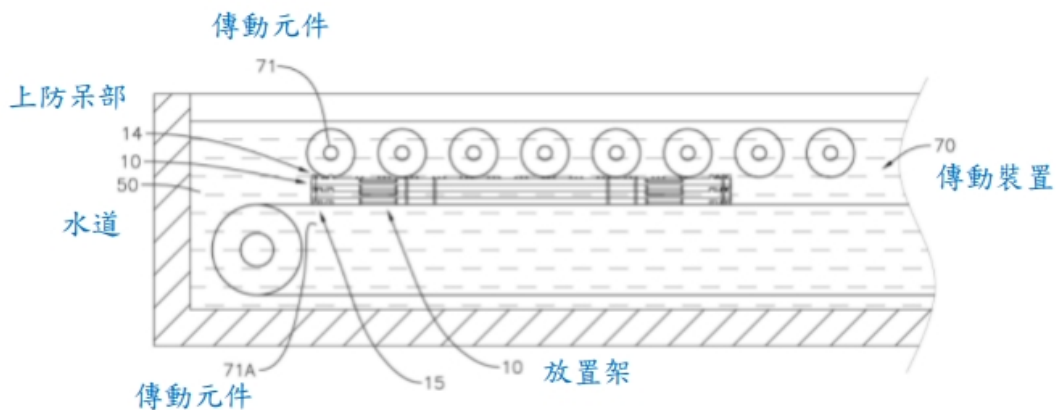
①圖1：放置架一角落的俯視局部立體圖



②圖2：放置架另一角落的俯視局部立體圖



01 ③圖3：放置架於水道清洗的使用狀態圖
02
03
04



05 (3)申請專利範圍：
06

07 請求項共14項，第1項為獨立項，其餘為附屬項：

08 ①請求項1：
09

09 一種具有防呆裝置之晶圓載片清洗治具(下稱要件1A)，其
10 包含：兩放置架，該兩放置架係能分離地疊合，各放置架
11 其包含一外環壁、複數個放置單元及複數個防呆部(下稱要
12 件1B)；該複數個放置單元排列設在該外環壁內而受該外環
13 壁圍繞，各放置單元包含一周壁及該周壁圍成的一容置空
14 間(下稱要件1C)；以及該複數個防呆部包含複數個卡合凸
15 塊，其凸設在該外環壁，該複數個卡合凸塊能與輸送該放
16 置架的一傳動裝置相卡合(下稱要件1D)。

17 ②請求項2：
18

18 如請求項1所述之具有防呆裝置之晶圓載片清洗治具，其包
19 含兩個所述之防呆部，該兩防呆部為一上防呆部及一下防
20 呆部，該上防呆部及該下防呆部分別位於該放置架的上表
21 面及下表面且能相卡合，該上防呆部與另一該上防呆部無
22 法互相卡合。

23 ③請求項3：
24

24 如請求項2所述之具有防呆裝置之晶圓載片清洗治具，其中
25 所述之放置架包含複數個限位件，其設在該周壁，該上防
26 呆部包含複數個所述的卡合凸塊，而該下防呆部包含能與
該複數個卡合凸塊相卡合的複數個卡合凹部，各卡合凹部

是凹設在該外環壁，各卡合凸塊的位置高於各限位件的上端。

④請求項4：

如請求項3所述之具有防呆裝置之晶圓載片清洗治具，其中所述之外環壁的輪廓為矩形，該上防呆部包含四組所述的卡合凸塊，該四組卡合凸塊分別位於該外環壁的四個角落，該下防呆部包含四組卡合凹部，該四組卡合凹部分別能與該四組卡合凸塊相卡合。

⑤請求項5：

如請求項4所述之具有防呆裝置之晶圓載片清洗治具，其中所述之上防呆部的形狀是對稱的。

⑥請求項6：

如請求項5所述之具有防呆裝置之晶圓載片清洗治具，其中所述之放置架包含至少一遮斷器，該至少一遮斷器設在該外環壁。

⑦請求項7：

如請求項6所述之具有防呆裝置之晶圓載片清洗治具，其中所述之放置架包含四個所述的遮斷器，該四遮斷器位於該放置架分別位於該放置架的四個角落。

⑧請求項8：

如請求項6所述之具有防呆裝置之晶圓載片清洗治具，其中所述之放置架包含八個夾制部，該八夾制部設在該外環壁，該外環壁的一側設有兩該夾制部。

⑨請求項9：

如請求項8所述之具有防呆裝置之晶圓載片清洗治具，各夾制部包含一斜面，該斜面位於該放置架的上表面。

⑩請求項10：

如請求項8所述之具有防呆裝置之晶圓載片清洗治具，其中所述之放置架包含複數個拿持部，各拿持部包含至少一排水孔。

⑪請求項11：

如請求項10所述之具有防呆裝置之晶圓載片清洗治具，其中所述之放置架包含兩所述之拿持部，各拿持部包含四排水孔。

⑫請求項12：

如請求項11所述之具有防呆裝置之晶圓載片清洗治具，各放置單元的周壁為矩形，且該放置單元包含複數個承載件，該複數個承載件不相連，各承載件設在該周壁、突入該容置空間且包含一頂面，該頂面朝向上方且為凸面。

⑬請求項13：

如請求項12所述之具有防呆裝置之晶圓載片清洗治具，各限位件為柱狀，該限位件的上端為凸面。

⑭請求項14：

如請求項13所述之具有防呆裝置之晶圓載片清洗治具，各限位件的外徑由其上端向下逐漸遞增。

2. 專利2：

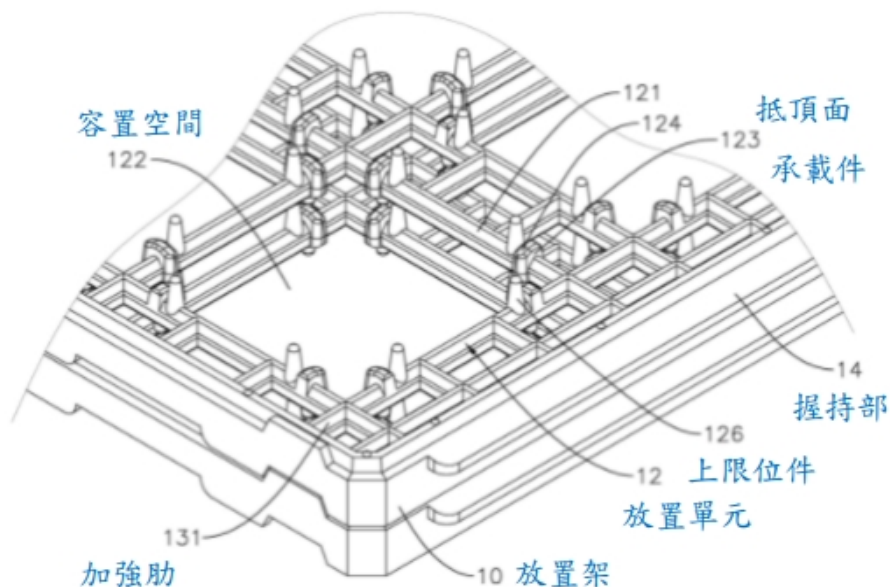
(1) 技術內容：

現有技術之晶圓載片厚度最大為3mm，因此位於下方承載件頂面至位於上方承載件底面間預留高度為3mm，當厚度小於3mm之晶圓載片置於放置單元之容置空間時，其上方即會產生一閒置空間，當利用超音波或高壓空氣對晶圓載片進行清潔時，容易導致晶圓載片產生上下方向之震動。又因清洗治具承載件頂面為一平面，與晶圓載片為面接觸，當晶圓載片震動時，貼靠於承載件部分會因連續的敲擊摩擦產生大面積之刮痕，導致成品良率下降。有鑒於現有技術之缺點與不足，專利2提供一種晶圓載片清洗治具，藉由將承載件抵頂面設置為斜面，且自位於該內框上方位置朝向該容置空間方向向下傾斜，達到在清洗過程中降低晶圓載片與抵頂面因碰撞而產生表面刮痕之目的。藉由將承載件抵頂面及底面皆設置為斜面，即使清洗晶圓載片過程中因晶圓載片受壓而產生震動擺盪持續碰觸敲擊到承載件抵頂面或斜面，相較於現有技術承載件以面接觸形式支撐晶圓載片，專利2以線接觸形式支

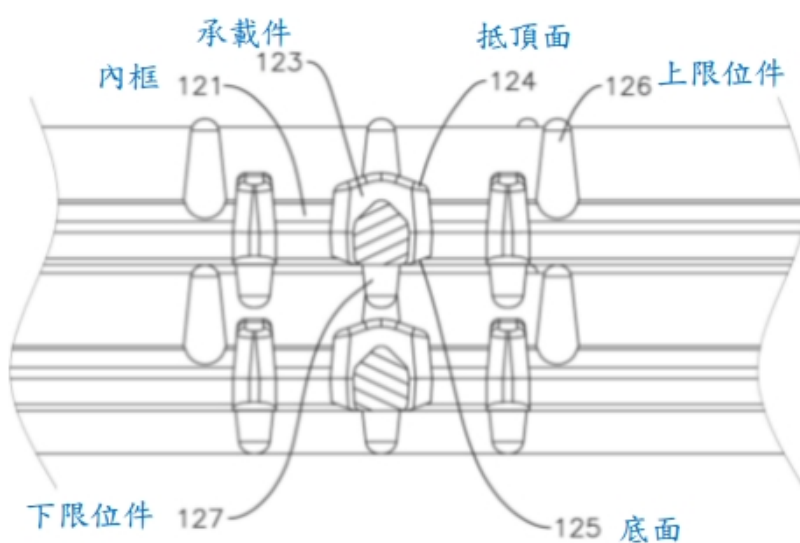
撐晶圓載片，於碰撞時可有效降低晶圓載片表面刮痕，進而提升產品品質，降低產品不良率。

(2)主要圖式：

①圖4：局部放大圖



②圖5：局部剖面圖



(3)申請專利範圍：

請求項共7項，第1項為獨立項，其餘為附屬項：

①請求項1：

一種晶圓載片清洗治具(下稱要件2A)，其包含：二放置架，其結構相同且能分離地相互疊合，各該放置架包含一外框及複數放置單元，該外框為一環狀框體，該複數放置單元排列設置在該外框內(下稱要件2B)，各該放置單元包

01 含一內框、複數承載件及複數上限位件，該內框圍繞形成
02 一容置空間，該複數承載件環繞間隔凸設於該內框上且朝
03 向該容置空間突伸(下稱要件2C)，各該承載件具有一抵頂
04 面，該抵頂面為一斜面，且自位於該內框的上方位置朝向
05 該容置空間的方向向下傾斜，其中，向下傾斜角度為以該
06 抵頂面的最高點與最低點之間連接之假想線與經過該抵頂
07 面最高點的假想水平線之間的夾角角度(下稱要件2D)，該
08 複數上限位件環繞間隔凸設於該內框的頂側面(下稱要件2
09 E)。

10 ②請求項2：

11 如請求項1所述之晶圓載片清洗治具，其中各該承載件進一
12 步包含一底面，該底面為一斜面且朝向該容置空間的方向
13 向上傾斜。

14 ③請求項3：

15 如請求項1或2所述之晶圓載片清洗治具，其中各該上限位
16 件為一錐狀體，其外徑朝向上方方向延伸逐漸減少。

17 ④請求項4：

18 如請求項3所述之晶圓載片清洗治具，其中各該放置單元進
19 一步包含複數下限位件，各該下限位件環繞間隔凸設於該
20 內框的底側面。

21 ⑤請求項5：

22 如請求項4所述之晶圓載片清洗治具，其中該複數下限位件
23 為錐狀體，其外徑朝向下方方向延伸逐漸減少。

24 ⑥請求項6：

25 如請求項5所述之晶圓載片清洗治具，其中該抵頂面的向下
26 傾斜角度為20度。

27 ⑦請求項7：

28 如請求項6所述之晶圓載片清洗治具，其中該底面的向上傾
29 斜角度為20度。

30 (二)系爭產品技術分析：

31 1.技術內容：

系爭產品皆為晶圓載片清洗治具，其放置架具有○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

2.正面俯視圖：

(1)圖6：產品1

(2)圖7：產品2

(3)圖8：產品3

(4)圖9：產品4

(三)系爭產品未落入專利1請求項1至14之文義範圍：

1.請求項1之部分：

(1)請求項1之技術特徵可解析為如(一)1.(3)①所示要件1A至1D。

(2)請求項1與系爭產品技術特徵之要件比對：

①要件1A部分：

①依上開保全證據事件光碟資料中，SH000000(1)-SH000000(3)之產品1照片；SH0000000000(1)-SH0000000000(3)之產品2照片；HY000000(1)-HY000000(3)之產品3照片；ZD00000(1)-ZD000000(3)之產品4照片，可知系爭產品皆為晶圓載片清洗治具，落入請求項1「一種具有防呆裝置之晶圓載片清洗治具」之要件1A技術特徵文義範圍。

②欣興公司固辯以專利1所指之「晶圓」即「晶圓片」，而「晶圓載片」乃裝設有「晶圓片」之載體，市面上IC製造之矽晶圓面積規格為直徑3吋至12吋，專利1係承載並清洗晶圓之裝置，非承載並清洗晶片之裝置云云(見限制閱覽卷(一)第311至317頁)。經查，依專利1說明書第【0002】段記載：「晶圓載片上會裝設有晶圓片。在完成晶圓片的裝設後，會對晶圓載片進行電路蝕刻，以及將晶圓

載片切割成較小的片狀，完成前述步驟後，為了清除蝕刻電路過程所殘留的油墨，以及清除切割晶圓載片過程所產生的碎屑，會對晶圓載片的表面進行清洗，以避免油墨和碎屑影響晶圓和整片晶圓載片的使用效能」、第【0003】段記載：「請配合參看圖12及圖13，是將晶圓載片80放置並固定在放置架90，放置架90包括有多個格狀的容置空間，並包含位於該容置空間的支撐肋92及通風孔91，以及分別位於放置架90上、下表面的上防呆部93及下防呆部94，支撐肋92連接在容置空間的周壁且為X形，而形成四個通風孔91，晶圓載片80會被放在該容置空間內並受支撐肋92支撐」之技術內容，及專利1圖12、13可看出晶圓載片係放置在放置架格狀容置空間內，可認專利1之「晶圓載片」不可能係被告所指3吋至12吋之「晶圓片」之載體。又依專利1說明書第【0002】段所載之技術內容，該技術領域中具有通常知識者能輕易得知專利1所述之「晶圓」係指從被告所述之3吋至12吋之「晶圓片」切割得來之晶圓，即習知技術所稱之「裸晶」，且該段明確記載「會對晶圓載片進行電路蝕刻…清除蝕刻電路過程所殘留的油墨」，可知所述之「晶圓載片」非半導體製程產物，而係印刷電路板(PCB)製程之產物，故在過程中會產生油墨，因此專利1之「晶圓載片」係指裸晶之載板或基板，裸晶(即專利1之晶圓片)與載板(即專利1之晶圓載片)封裝後即為市面上可見之晶片(IC)。專利1請求項1之「晶圓載片清洗治具」即是將封裝前之裸晶與載板予以清洗之承載治具，欣興公司此部分所辯，委無足採。

②要件1B：

上開保全證據事件光碟資料中系爭產品照片，及本院當庭拍攝之SH00000有文字面側拍圖、SH00000000000000有文字面側拍圖、HY00000有文字面側拍圖、ZD00000有文字面側拍圖照片(見限制閱覽卷(一)第473、493、513、531頁)，均為清洗治具○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○，落入請求項1「其包含：兩放置架，該兩
放置架係能分離地疊合，各放置架其包含一外環壁、複數
個放置單元及複數個防呆部」之要件1B技術特徵文義範
圍。

③要件1C：

依上開保全證據事件光碟資料中系爭產品照片，及本院當
庭拍攝之系爭產品照片(見限制閱覽卷(一)第465至541頁)，
可看出○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○，落入請求
項1「該複數個放置單元排列設在該外環壁內而受該外環壁
圍繞，各放置單元包含一周壁及該周壁圍成的一容置空
間」之要件1C技術特徵文義範圍。

④要件1D：

①依上開保全證據事件光碟資料中系爭產品照片，及本院
當庭拍攝之系爭產品照片(見限制閱覽卷(一)第465至541
頁)，可知○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○，落入請求項1「該
複數個防呆部包含複數個卡合凸塊，其凸設在該外環
壁」之要件1D技術特徵前半段文義範圍。

②依上開①照片，無法看出○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○，且依上開保全證據事件光碟資
料中00081.MTS、00084.MTS、00085.MTS、00086.MTS影
片顯示，○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○，系爭產品未落入請求
項1「該複數個卡合凸塊能與輸送該放置架的一傳動裝置
相卡合」之要件1D技術特徵後半段文義範圍。

01 ③原告雖主張系爭專利之清洗治具構造未含○○○○○○○
02 ○○○○，系爭產品能否與欣興公司提供之○○○○○○
03 ○○，非判斷是否落入系爭專利範圍之要件云云(見本院
04 卷(四)第153頁)。惟請求項1所載「該複數個卡合凸塊能與
05 輸送該放置架的一傳動裝置相卡合」之技術內容，已限
06 定清洗治具放置架上的卡合凸塊必須具備與傳動裝置相
07 卡合功能，傳動裝置本身雖非請求項範圍之限定條件，
08 但判斷系爭產品是否落入請求項1之範圍，仍須就系爭產
09 品是否具有卡合凸塊結構及該卡合凸塊是否具備與傳動
10 裝置相卡合功能判斷。由系爭產品實體及照片雖能看到
11 有○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
12 ○○○○，但無法得知系爭產品之○○○○○○○○○○○○
13 ○○○○○○，再由上開②之影片，可知系爭產品在實際
14 應用時○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
15 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○，難以認定系爭產品落入
16 請求項1之要件1D技術特徵後半段文義範圍。

17 (3)綜上，系爭產品因未落入請求項1技術特徵要件1D後半段
18 「該複數個卡合凸塊能與輸送該放置架的一傳動裝置相卡
19 合」之技術特徵，自未落入請求項1之文義範圍。

20 2.系爭產品未落入請求項2至14之文義範圍：

21 請求項2至14係直接或間接依附請求項1而包含請求項1之技
22 術特徵，系爭產品未落入請求項1之文義範圍，當然未落入
23 請求項2至14之文義範圍。

24 (四)專利2請求項1、3至6不具進步性：

25 1.請求項1部分：

26 請求項1之技術特徵可解析為如(一)2.(3)①所示要件2A至2E。

27 2.被證3不足以證明請求項1、3至5不具新穎性、進步性：

28 (1)被證3說明書之發明名稱為「具有防呆裝置的晶圓載片清洗
29 治具」，可對應請求項1「一種晶圓載片清洗治具」之要件
30 2A技術特徵；被證3請求項1記載「其包含：兩放置架，該
31 兩放置架係能分離地疊合，各放置架其包含一外環壁、複
32 數個放置單元…該複數個放置單元排列設在該外環壁內而

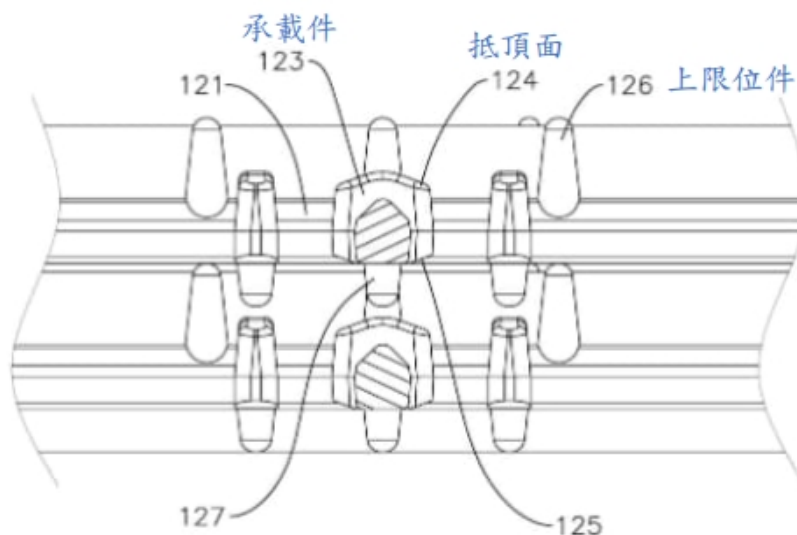
受該外環壁圍繞」，由被證3圖1可看出被證3之「外環壁」為環狀框體，可對應請求項1之「外框」，故被證3請求項1、圖1可對應請求項1「其包含：二放置架，其結構相同且能分離地相互疊合，各該放置架包含一外框及複數放置單元，該外框為一環狀框體，該複數放置單元排列設置在該外框內」之要件2B技術特徵；被證3請求項1記載「各放置單元包含一周壁及該周壁圍成的一容置空間」、被證3請求項9記載「各放置單元包含多個承載件，該多個承載件不相連，各承載件設在該周壁、突入該容置空間」、被證3說明書第【0052】段記載「各放置單元12會被該多個限位件13導入容置空間並受該多個承載件122支撐」，比較被證3圖3與專利2圖3，可看出被證3之「周壁121」對應請求項1之「內框」，被證3之「承載件122」對應請求項1之「承載件」，被證3之「限位件13」對應請求項1之「上限位件」，故被證3請求項1、9、說明書第【0052】段、圖3可對應請求項1「各該放置單元包含一內框、複數承載件及複數上限位件，該內框圍繞形成一容置空間，該複數承載件環繞間隔凸設於該內框上且朝向該容置空間突伸」之要件2C技術特徵；被證3請求項10記載「各限位件設在該周壁的頂面」，由被證3圖3可看出複數限位件13環繞間隔凸設於周壁121上，故被證3請求項10、圖3可對應請求項1「該複數上限位件環繞間隔凸設於該內框的頂側面」之要件2E技術特徵。

- (2)專利2說明書第【0016】段記載：「承載件123為一自內框121朝向容置空間122突伸之塊體，其具有一抵頂面124及一底面125，抵頂面124為一斜面，抵頂面124自位於內框121上方位置朝向容置空間122的方向向下傾斜」、第【0021】段記載：「各晶圓載片20會被上限位件126導入容置空間122直至晶圓載片20的下緣貼靠於承載件123的抵頂面124而停止，此時承載件123與晶圓載片20之間是以線接觸的方式貼靠達到承載之目的」。參諸專利2圖3、4，可知專利2承載件之頂面雖為凸面，但自頂面向下傾斜之抵頂面為直線之

01 斜面(如下圖10所示)，且承載件與晶圓載片下緣接觸的部位
02 位為抵頂面而非承載件頂面或其他非抵頂面的部位(如下圖
03 11橘線所示)。然被證3說明書第【0045】段記載：「各承
04 載件122突入該容置空間，且該承載件122包含一頂面，該
05 頂面朝向上方且為凸面」、被證3說明書第【0052】段記
06 載：「請參看圖8及圖9…各放置單元12會被該多個限位件1
07 3導入容置空間並受該多個承載件122支撐」。參諸被證3圖
08 8、9，可看出承載件122頂面為凸面，晶圓載片下緣係與承
09 載件頂面接觸(如下圖12所示)，故被證3未揭露請求項1
10 「各該承載件具有一抵頂面，該抵頂面為一斜面，且自位
11 於該內框的上方位位置朝向該容置空間的方向向下傾斜，其
12 中，向下傾斜角度為以該抵頂面的最高點與最低點之間連
13 接之假想線與經過該抵頂面最高點的假想水平線之間的夾
14 角角度」之要件2D技術特徵。

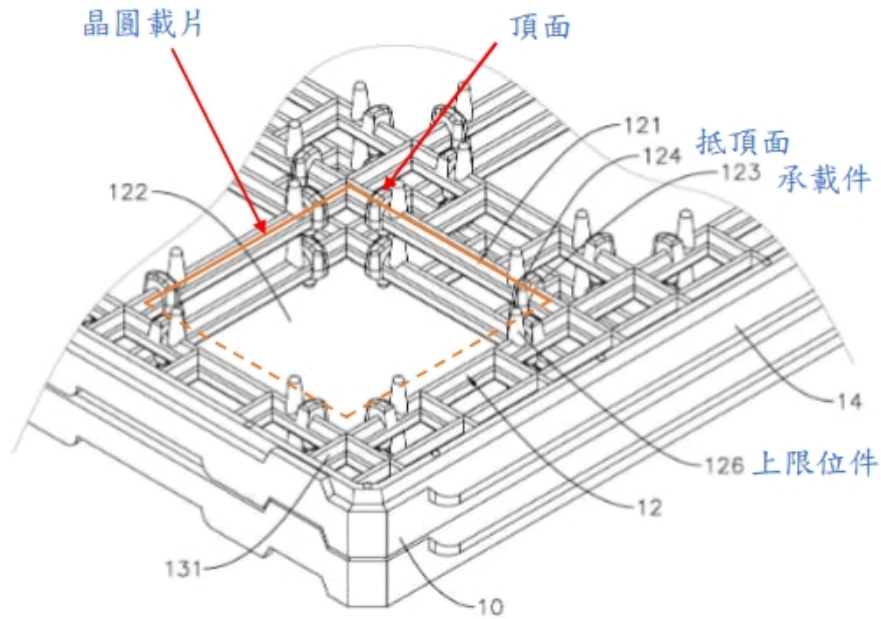
15 (3)從而，被證3不足以證明請求項1不具新穎性。

16 圖10(專利二圖4)：專利2清洗治具局部剖面
17



18 圖11(專利二圖3)：專利2清洗治具局部放大圖

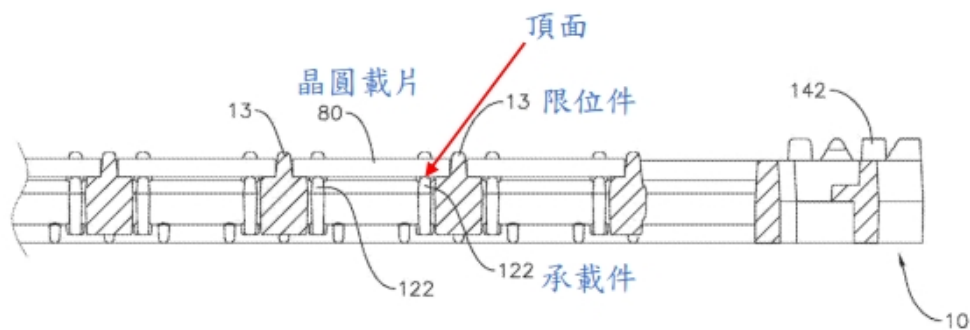
01



02

圖12(被證3圖9)：被證3清洗治具局部放大圖

03



04

(4)專利2說明書第【0021】段記載「各晶圓載片20會被上限位件126導入容置空間122直至晶圓載片20的下緣貼靠於承載件123的抵頂面124而停止，此時承載件123與晶圓載片20之間是以線接觸的方式貼靠達到承載之目的」、「由於承載件123的抵頂面124及底面125皆為斜面，因此當清洗的過程中即便晶圓載片20因為受壓而產生震動擺盪的情形，由於僅晶圓載片20片體表面與周緣面之間的上、下轉角邊緣碰觸敲擊到承載件123的抵頂面124或斜面，相較於現有技術的面接觸形式，本新型以線接觸的碰撞可有效降低晶圓載片20表面的刮痕，進而提升產品的品質，降低產品的不良率」，可知將承載件與晶圓載片接觸部分改成斜面之抵頂面係專利2能達到其發明目的之重要技術特徵，具有降低晶圓載片表面的刮痕，進而

16

提升產品的品質、降低產品的不良率之功效，難謂此項技術特徵為該技術領域中具有通常知識者能利用申請時之通常知識簡單進行修飾、置換、省略或轉用即可完成，故被證3不足以證明請求項1不具進步性。

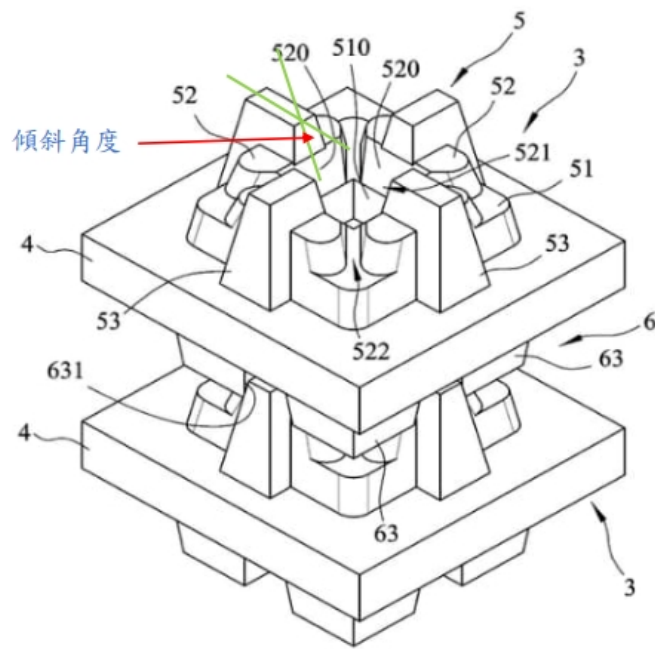
(5)請求項3至5係直接或間接依附請求項1，包含請求項1所有技術特徵，被證3不足以證明請求項1不具新穎性、進步性，當然亦不足以證明請求項3至5不具新穎性、進步性。

3.被證3及被證4之結合足以證明請求項1、3至6不具進步性：

(1)被證3已揭露請求項1之要件2A至2C、2E之技術特徵，已如前述，而依被證4說明書第【0009】段所載：「四個環狀相間隔地凸設於該第一圍繞壁51上且各自形成一傾斜面520的限位壁52…該等傾斜面520相配合界定出一連通該第一凹槽510的承載空間521」、第【0011】段所載：「該晶片C的外周緣會靠抵於該晶片承載裝置3a之該等傾斜面520上」。參諸被證4圖4、6，可知被證4揭露之限位壁52具有一傾斜面520，由第一圍繞壁51之上方位位置向第一凹槽510之方向向下傾斜，其中傾斜面520高點與最低點之間連接之假想線與傾斜面最高點的假想水平線間具有一傾斜角度(如下圖13所示)，當晶片C置放於第一凹槽510時，晶片C的外周緣會靠抵於傾斜面520上形成線接觸(如下圖14所示)。因此被證4之「傾斜面520」對應請求項1之「抵頂面」，被證4之「第一凹槽510」對應請求項1之「容置空間」，故被證4說明書第【0009】、【0111】段、圖4、6可對應請求項1「各該承載件具有一抵頂面，該抵頂面為一斜面，且自位於該內框的上方位位置朝向該容置空間的方向向下傾斜，其中，向下傾斜角度為以該抵頂面的最高點與最低點之間連接之假想線與經過該抵頂面最高點的假想水平線之間的夾角角度」之要件2D技術特徵。

圖13(被證4圖4)：被證4晶片承載裝置上下疊置示意圖

01

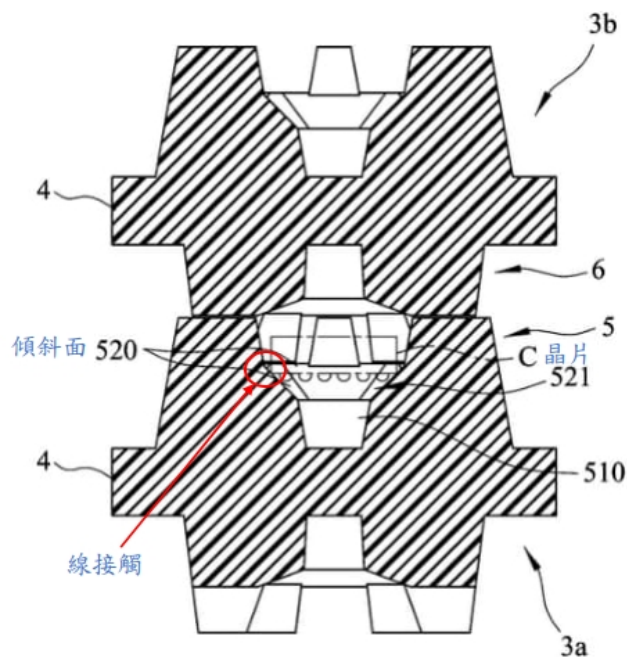


02

圖14(被證4圖6)：被證4晶片承載裝置承載晶片時剖面圖

03

04



05

(2)原告雖主張被證3、4欠缺結合動機云云。惟被證3、4皆為承載晶圓載片的治具，具有技術領域關連性；被證3、4皆具有放置晶圓載片，使在製程中運送之晶圓載片不會發生碰撞、散亂而損壞晶片，具有功能或作用之共通性；被證3說明書第【0052】段記載：「晶圓載片80放入該放置單元12的容置空間時…各放置單元12會被該多個限位件13導入容置空間並受該多個承載件122支

06

07

08

09

10

11

撐」、被證4說明書第【0011】段記載：「將該晶片C置於該晶片承載裝置3a之承載空間521內，前述的置入過程中，該晶片C的外周緣會靠抵於該晶片承載裝置3a之該等傾斜面520上」，被證3已揭露以承載件接觸晶圓載片，被證4則教示並建議承載件係以傾斜面的方式與晶圓載片接觸，故被證4已教示或建議可與被證3結合。綜合考量被證3、4間技術內容的關連性和共通性，該技術領域中具有通常知識者自有動機結合被證3、4揭露之技術內容，將被證4之傾斜面結構應用於被證3之承載件上，完成請求項1「各該承載件具有一抵頂面，該抵頂面為一斜面，且自位於該內框的上方位置朝向該容置空間的方向向下傾斜，其中，向下傾斜角度為以該抵頂面的最高點與最低點之間連接之假想線與經過該抵頂面最高點的假想水平線之間的夾角角度」之要件2D技術特徵。

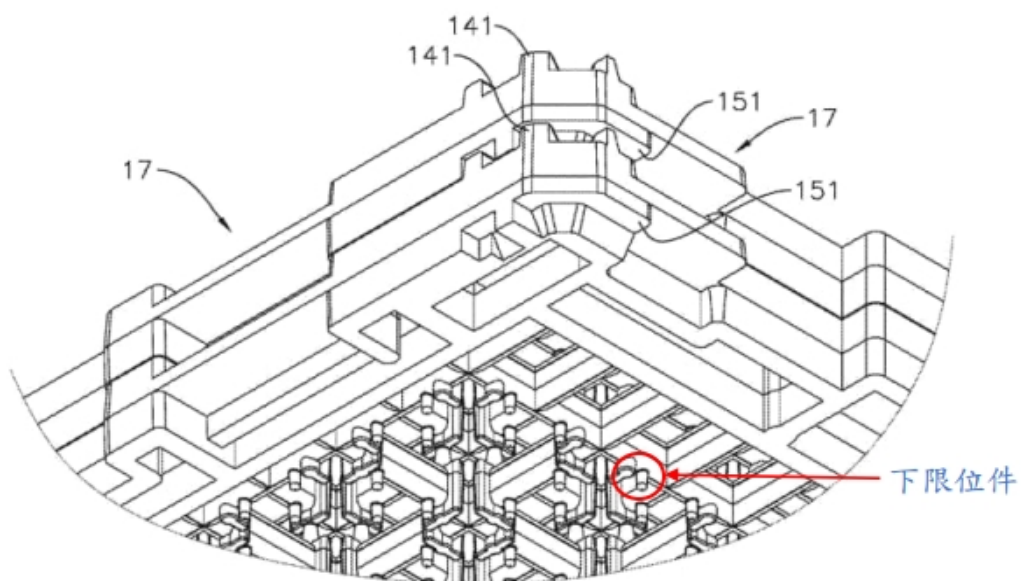
(3)綜上，被證3及被證4之組合足以證明請求項1不具進步性。

(4)請求項3依附於請求項1或2，被證3及被證4之組合足以證明請求項1不具進步性，請求項3進一步界定「各該上限位件為一錐狀體，其外徑朝向上方方向延伸逐漸減少」之附屬技術特徵。查被證3說明書第【0045】段記載「該限位件13的外徑是由其上端向下逐漸遞增」、被證3說明書第【0052】段記載「各限位件13是外徑由上端向下逐漸遞增的柱體」。參諸被證3圖3、8，可知被證3之限位件13為一錐狀體，其外徑朝向上方方向延伸逐漸減少，被證3已揭露請求項3「各該上限位件為一錐狀體，其外徑朝向上方方向延伸逐漸減少」之技術特徵，故被證3及被證4之組合足以證明請求項3不具進步性。

(5)請求項4依附於請求項3，請求項5依附於請求項4，被證3及被證4之組合足以證明請求項3不具進步性，已如前述，請求項4進一步界定「各該放置單元進一步包含複

數下限位件，各該下限位件環繞間隔凸設於該內框的底側面」之附屬技術特徵；請求項5進一步界定「該複數下限位件為錐狀體，其外徑朝向下方向延伸逐漸減少」之附屬技術特徵。查被證3圖6係清洗治具放置架之背面仰視圖，由被證3圖6、8可知其揭露之清洗治具有複數下限位件，且下限位件環繞間隔凸設於該內框底側面(如下圖15所示)，其中下限位件為錐狀體，其外徑朝向下方向延伸逐漸減少，被證3已揭露請求項4「各該放置單元進一步包含複數下限位件，各該下限位件環繞間隔凸設於該內框的底側面」及請求項5「該複數下限位件為錐狀體，其外徑朝向下方向延伸逐漸減少」之技術特徵，故被證3及被證4之組合足以證明請求項4、5不具進步性。

圖15(被證3圖6)：被證3清洗治具放置架背面仰視圖



(6)請求項6依附於請求項5，被證3及被證4之組合足以證明請求項5不具進步性，已如前述，請求項6進一步界定「該抵頂面的向下傾斜角度為20度」之附屬技術特徵。查被證4已揭露與晶圓載片接觸之傾斜面高點與最低點之間連接之假想線與傾斜面最高點的假想水平線之間具有一傾斜角度，因專利2說明書中並無說明傾斜角度設定為20度有產生任何特殊功效或與其他角度相比有何特殊之處，故被證4雖未揭露該傾斜角度數值，然該技術領域中

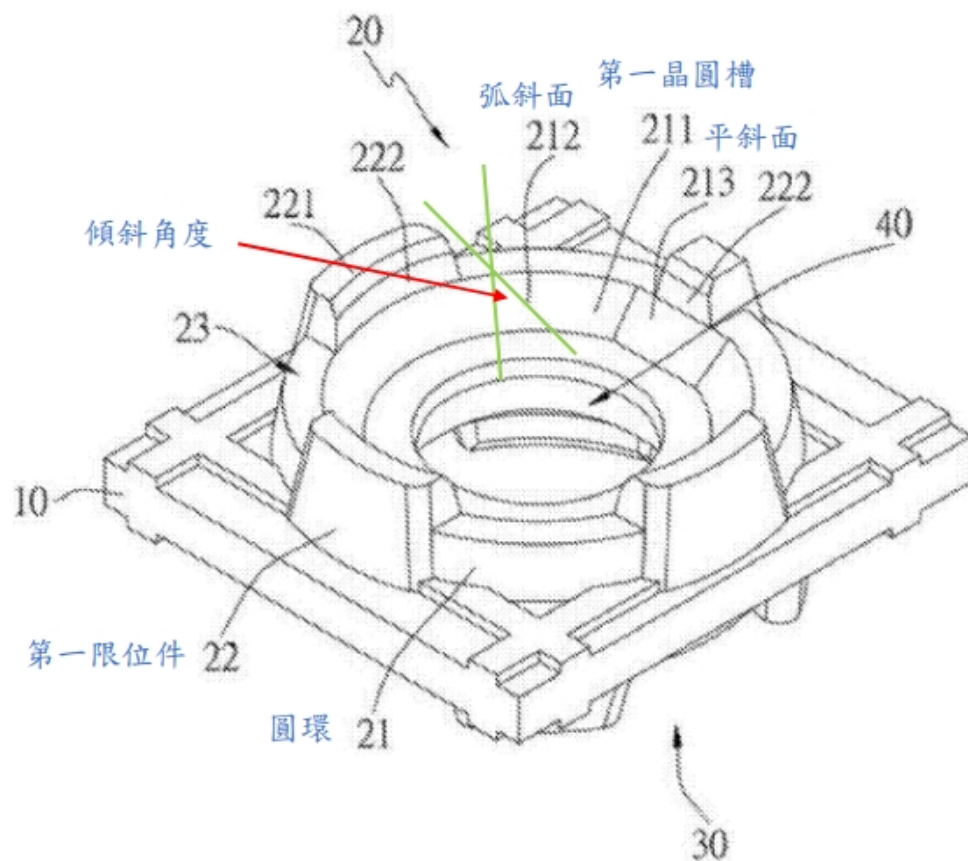
具有通常知識者能由實際生產需求而無須過度實驗即可輕易得知傾斜角度可設為20度，被證3及被證4之組合足以證明請求項6不具進步性。

4.被證3及被證25之組合足以證明專利2請求項1、3至6不具進步性：

(1)被證3已揭露請求項1之要件2A至2C、2E之技術特徵，已如前述，被證25說明書第【0025】段記載：「該第一容置結構20具有一由該基底部10突出以圈圍出一第一晶圓槽211的圓環21以及四個設置於該圓環外側面的第一限位件22。該圓環21的內側有朝向該圓環21中心傾斜的一弧斜面212以及一平斜面213」、被證25說明書第【0027】段記載：「晶圓50置放於該第一容置結構20的第一晶圓槽211中時，該晶圓50的平面邊緣51對應該平斜面213，該弧面邊緣52對應該弧斜面212的部分」。參諸被證25圖1、5，可看出被證25揭露之晶圓承盤中與晶圓接觸部分為圓環21的內側弧斜面212及平斜面213，由圓環21的上方位向穿孔40的方向向下傾斜，其中弧斜面212及平斜面213的高點與最低點之間連接之假想線與最高點的假想水平線之間具有一傾斜角度(如下圖16所示)，當晶圓50置放於第一晶圓槽211時，晶圓50的外周緣會靠抵於弧斜面212及平斜面213上形成線接觸(如下圖17所示)。因此被證25之「弧斜面212」或「平斜面213」對應請求項1之「抵頂面」，被證25之「第一晶圓槽211」對應請求項1之「容置空間」，故被證25說明書第【0025】、【0027】段、圖1、5可對應請求項1「各該承載件具有一抵頂面，該抵頂面為一斜面，且自位於該內框的上方位向朝向該容置空間的方向向下傾斜，其中，向下傾斜角度為以該抵頂面的最高點與最低點之間連接之假想線與經過該抵頂面最高點的假想水平線之間的夾角角度」之要件2D技術特徵。

圖16(被證25圖1)：被證3清洗治具放置架的背面仰視圖

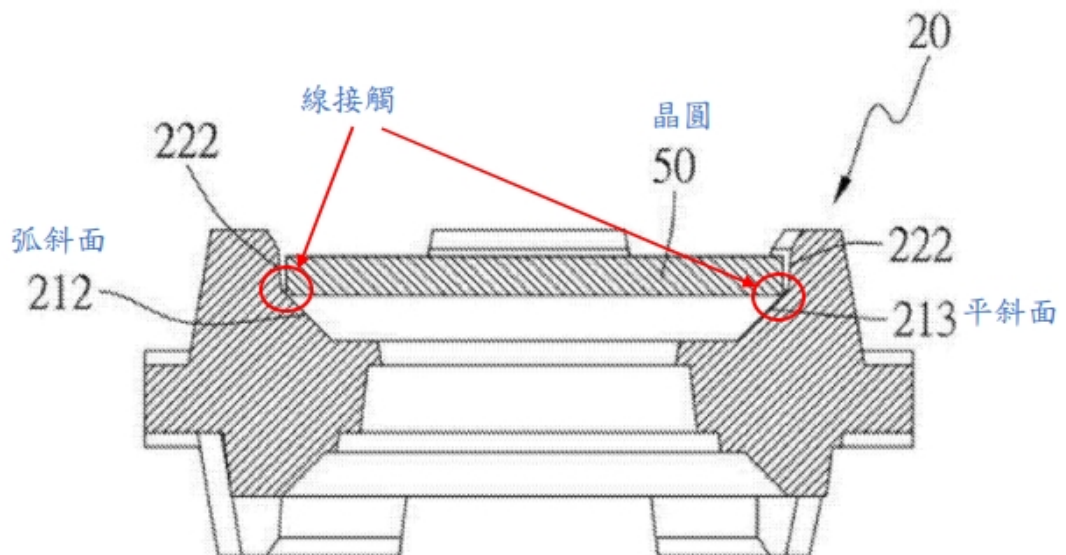
01



02

圖17(被證25圖5)：被證25晶圓承盤承載晶圓時的剖面圖

03



04

05

06

07

08

(2)原告主張被證3與被證25欠缺結合動機云云。惟被證3與被證25雖分別為承載晶圓載片與晶圓之治具，然皆為半導體製程中搬運半導體產品之治具，具有技術領域關連性；被證3與被證25皆具有放置晶圓載片或晶圓，使製程中運送之晶圓載片或晶圓不會因碰撞、震動而損壞，具有功能或

作用之共通性；被證3說明書第【0052】段記載：「晶圓載片80放入該放置單元12的容置空間時…各放置單元12會被該多個限位件13導入容置空間並受該多個承載件122支撐」、被證25說明書第【0027】段記載：「晶圓50置放於該第一容置結構20的第一晶圓槽211中時，該晶圓50的平面邊緣51對應該平斜面213，該弧面邊緣52對應該弧斜面212的部分…該晶圓50與該弧斜面212以及該平斜面213構成的線接觸狀態，可減少摩擦與不當接觸的損壞」，被證3已揭露以承載件接觸晶圓載片，被證25則教示並建議承盤係以傾斜面的方式與晶圓載片接觸，故被證25已教示或建議可與被證3結合。綜合考量被證3、25間技術內容的關連性和共通性，該技術領域中具有通常知識者自有動機以結合被證3與被證25揭露之技術內容，將被證25之傾斜面結構應用於被證3之承載件上，完成請求項1「各該承載件具有一抵頂面，該抵頂面為一斜面，且自位於該內框的上方位位置朝向該容置空間的方向向下傾斜，其中，向下傾斜角度為以該抵頂面的最高點與最低點之間連接之假想線與經過該抵頂面最高點的假想水平線之間的夾角角度」之要件2D技術特徵。

(3)綜上，被證3及被證25之組合足以證明請求項1不具進步性。

(4)請求項3依附於請求項1或2，被證3及被證25之組合足以證明請求項1不具進步性，已如前述，請求項3進一步界定「各該上限位件為一錐狀體，其外徑朝向上方方向延伸逐漸減少」之附屬技術特徵，而被證3已揭露請求項3「各該上限位件為一錐狀體，其外徑朝向上方方向延伸逐漸減少」之技術特徵，已如前述，故被證3及被證25之組合足以證明請求項3不具進步性。

(5)請求項4依附於請求項3，請求項5依附於請求項4，被證3及被證25之組合足以證明請求項3不具進步性，已如前述，請求項4進一步界定「各該放置單元進一步包含複數下限位件，各該下限位件環繞間隔凸設於該內框的底側

面」之附屬技術特徵；請求項5進一步界定「該複數下限位件為錐狀體，其外徑朝向下方向延伸逐漸減少」之附屬技術特徵。查被證3已揭露請求項4「各該放置單元進一步包含複數下限位件，各該下限位件環繞間隔凸設於該內框的底側面」及請求項5「該複數下限位件為錐狀體，其外徑朝向下方向延伸逐漸減少」之技術特徵，均如前述，故被證3及被證25之組合足以證明請求項4、5不具進步性。

(6)請求項6依附於請求項5，被證3及被證25之組合足以證明請求項5不具進步性，已如前述，請求項6進一步界定「該抵頂面的向下傾斜角度為20度」之附屬技術特徵。查被證25已揭露與晶圓接觸之弧斜面或平斜面高點與最低點之間連接之假想線與弧斜面或平斜面最高點的假想水平線之間具有一傾斜角度，因專利2說明書中並無說明傾斜角度設定為20度有產生任何特殊功效或與其他角度相比有何特殊之處，故被證25雖未揭露該傾斜角度數值，然該技術領域中具有通常知識者能由實際生產需求而無須過度實驗即可輕易得知傾斜角度可設為20度，被證3及被證25之組合足以證明請求項6不具進步性。

六、綜上所述，系爭產品均未落入專利1請求項1至14之文義範圍，不構成侵害專利1之專利權，且專利2請求項1、3至6均不具進步性而有得撤銷之原因，依智慧財產案件審理法第16條第2項規定，原告於本件民事訴訟不得依專利法對被告主張權利，則原告以超登公司等5公司侵害系爭專利，依專利法第120條準用第96條第1項、第3項、第4項規定請求排除侵害，並依同法第120條準用第96條第2項、第4項、民法第184條第1項前段、第185條第1項、公司法第23條第2項規定，請求被告各就產品1、2連帶賠償200萬；產品3、4各連帶賠償100萬元，及自起訴狀或訴之變更追加狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息，均無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所依附，應一併駁回之。

01 七、本件事證已臻明確，兩造其餘爭點、攻擊防禦方法及證據
02 資料，經本院審酌後認與判決結果不生影響，爰不一一論
03 列。又原告既不得以專利權遭侵害請求被告排除侵害或給
04 付款項，本件即無另為中間判決之必要，爰為終局判決，
05 併此敘明。

06 八、本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，
07 民事訴訟法第78條，判決如主文。

08 中 華 民 國 112 年 5 月 31 日

09 智慧財產第四庭

10 法 官 林昌義

11 以上正本係照原本作成。

12 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如
13 委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

14 中 華 民 國 112 年 6 月 1 日

15 書記官 張禎庭